

# 연수 제안서

연구 분야	물리/재료/전자
연구 과제명	양자자기장 센서를 이용한 미세 불량 검출 장치
연수 제안 업무	양자센서용 미세패턴 및 식각공정
<p>(연수 내용)</p> <p>- 연수기간 : 2023.3.1. ~ 2023.11.30. (9개월)</p> <p>- 연수 내용 :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 양자센서용 소재 나노패터닝 이빔리소그래피 및 박막 증착을 통한 미세 나노 구조 패터닝</li><li>- 양자센서용 소재 식각 공정 연구 식각 공정 최적화 및 안정화 연구</li><li>- 반도체 공정 장비를 활용한 차세대 반도체 소자 공정 및 특성 측정</li></ul>	
소속 부 서 : 스핀융합연구단	
연수 책임자 : 장차운	